

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年10月11日 (2012.10.11)

【公開番号】特開2012-4464(P2012-4464A)

【公開日】平成24年1月5日 (2012.1.5)

【年通号数】公開・登録公報2012-001

【出願番号】特願2010-139998(P2010-139998)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

H 0 1 L 25/065 (2006.01)

H 0 1 L 25/07 (2006.01)

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 0 1 D

H 0 1 L 21/60 3 0 1 B

H 0 1 L 25/08 Z

【手続補正書】

【提出日】平成24年8月21日 (2012.8.21)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】

前記第 1 半導体素子の前記第 1 電極が設けられる側の主面に積層された第 2 半導体素子をさらに備え、

前記第 2 電極は、前記第 2 半導体素子に電気的に接続され、

前記ワイヤは、前記第 1 電極の上方と、前記第 2 電極の上方と、の間において、前記第 1 半導体素子の主面及び前記第 2 半導体素子の主面に対して実質的に平行であることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 つに記載の半導体装置。